

Title (en)

A MODULAR PLATE FOR THERMIC SYSTEMS.

Title (de)

PLATTENFÖRMIGES ELEMENT FÜR TEMPERIERSYSTEME.

Title (fr)

PLAQUE MODULAIRE POUR SYSTEMES THERMIQUES.

Publication

**EP 0304433 A1 19890301 (EN)**

Application

**EP 87904309 A 19870619**

Priority

IT 4772987 A 19870316

Abstract (en)

[origin: WO8807158A1] A modular plate according to the present invention, consisting of a metal blade (1) for the housing of a feeding duct (5) of a thermoconductor fluid, and of a closing blade (2) which, together with said first blade, defines a chamber filled up with an insulating material (3) in which a strengthening beam (14) may be drowned or at least a duct (15) for the housing of electric or telephone cables. The longitudinal edges (6) of said metal blade (1) being folded and shaped so as to form contours (7 and 7') being opposed on the two longitudinal edges (6) and that may be coupled with the corresponding edges of adjacent blades so as to avoid a reciprocal movement of the same in the position plane thereof.

Abstract (fr)

Une plaque modulaire se composant d'une lame de métallique (1) pour le logement d'une conduite d'alimentation (5) d'un fluide thermoconducteur, et d'une lame de fermeture (2) qui, conjointement avec ladite première lame, définit une chambre remplie d'un matériau isolant (3) dans laquelle peut être noyée une poutre de renforcement (14), ou au moins une conduite (15) destinée au logement de cables électriques ou téléphoniques. Les bords longitudinaux (6) de ladite lame métallique (1) étant repliés et profilés de manière à former des contours (7 et 7') opposés sur les deux bords longitudinaux (6) et qui peuvent être couplés avec les bords correspondants des lames adjacents de manière à éviter un mouvement réciproque des bords dans leur plan de position.

IPC 1-7

**F24D 3/14**

IPC 8 full level

**F24D 3/14** (2006.01)

CPC (source: EP)

**F24D 3/142** (2013.01); **Y02B 30/00** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8807158A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 8807158 A1 19880922**; EP 0304433 A1 19890301; IT 1221502 B 19900706; IT 8747729 A0 19870316; JP H01502605 A 19890907

DOCDB simple family (application)

**IT 8700064 W 19870619**; EP 87904309 A 19870619; IT 4772987 A 19870316; JP 50400287 A 19870619